

# 熱伝導性シリコーングリース

High Thermal Interface Silicone Grease

# G-1000

## 【特長】 Features

- 低粘度・高チクソで作業性良好  
Workability is good at low viscosity and high thixotropy.
- オイルブリードレス、耐ポンプアウト  
Less pump-out and less oil bleed.
- 硬化前に部品の凹凸に追従するため、硬化後、高密着かつ低反発  
Before curing, it takes any shape to completely encapsulate components. After curing, the lowest TR can be achieved since it contacts with components without giving any mechanical pressure.
- 硬化に加熱不要、室温保管可能  
Heating is not required to cure, and possible to store at room temperature.
- リペア可能  
Repairable.

## 【用途】 Applications

- ECU内のマイコンやパワーICの放熱  
Thermal interface on micro-computer and power ICs for ECU.
- IGBTやMOSFETなどパワーモジュールの放熱  
Thermal interface for power modules, such as IGBT, MOSFET.
- 寸法公差の大きい箇所や部品段差がある部位の放熱  
Thermal interface for the part where dimensional tolerance is large.

## 【一般特性】 General Properties

項目 Parameter	製品名 Grade	G-1000
外観 Appearance		白色グリース状 White grease paste
比重 Specific Gravity at 25°C		3.0
粘度 Viscosity	Pa·s	100
揮発分 Volatile Content*1		0.5
熱伝導率 Thermal Conductivity	W/m·K*2	2.2
硬化後硬度 Hardness After Curing	アスカーC Asker C	40

\*1 試験条件 Test condition :150°C/24h

\*2 熱伝導率は京都電子工業株式会社TPA-501を用いて測定。  
Bulk thermal conductivity of uncured material was measured by thermophysical properties analyze (Kyoto electronics manufacturing, TPA-501)

(規格値ではありません Not specified values)

## 【硬化速度 (イメージ) Image】 Curing speed

